

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

## 江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2021年10月29日、2021年11月2日
地点	联瑞新材会议室及酒店会场 电话会议及现场会议
上市公司接待人员姓名	董事长李晓冬、董事会秘书柏林、副总经理曹家凯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分 介绍公司相关情况</b></p> <p>董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司发展历程、主营业务、产品应用、主要客户以及三季度经营等情况。</p> <p><b>第二部分 提问回答</b></p> <p><b>问题 1：公司三季度毛利率表现较好的原因是什么？成本会不会有较大压力？</b></p> <p>答：三季度增长主要源于球形品销量增长所致。</p> <p>公司始终注重与客户建立并已经形成长期稳定的信赖关系，市场经营策略依据长远的战略规划引导，不会因为成本变化而频繁调整市场价格。今年下半年以来，对于成本有较大的影响的天然气价格出现了异常增长，导致球形产品的成本出现阶段性增长，在关注一段时间的天然气价格走势后，我们和客户进行了有效的沟通，在取得客户理解并支持的情况下，公司</p>

投资者关系活动  
主要内容介绍

已经完成了球形产品第一轮价格上涨。目前我们一边紧锣密鼓推出高毛利产品，一边在继续关注天然气价格走势，以便和客户商讨。

**问题 2：三季度公司产品用在环氧塑封料和覆铜板行业提升幅度怎么样？**

答：三季度环氧塑封料行业增速较快。

**问题 3：在覆铜板行业，硅微粉与树脂等材料有什么区别？用量占比有多少？**

答：电子电路用覆铜板主要原材料为树脂、铜箔、玻纤布、填料等，树脂主要功能为提供机械、电气、阻燃等基本性能，铜箔主要功能为印制线路和传输电信号，玻纤布的主要功能为增强，填料的主要作用是改善机械、电气、阻燃等性能。硅微粉是覆铜板行业总体用量最大的一种填料，在电子电路用覆铜板中加入硅微粉可以改善印制电路板的线性膨胀系数、热传导率、介电常数、介质损耗等物理特性，从而有效提高电子产品的可靠性和信号传输特性。

硅微粉已成为电子产品里的关键基础材料之一，在覆铜板中的用量占比通常可达 30%以上，部分产品目前可达 50%-70%。

**问题 4：公司如何看待和华飞电子球形硅微粉成本方面的差异？**

答：公司是国内硅微粉行业的龙头企业，生产线设计、产品匹配合理，智能化水平高。产品规格多，产销量大，应用领域广。产品有结晶硅微粉、熔融硅微粉、软性硅微粉、改性（多种改性）硅微粉、球形硅微粉、球形氧化铝粉、亚微米球形硅微粉。

公司是工信部首批认定的“专精特新”小巨人企业，具有近 40 年的功能性陶瓷粉体材料领域的研发经验和技術积累，

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>掌握了原料优选及配方技术、高效研磨技术、颗粒设计技术、混合复配技术、高温球化技术、表面改性技术、智能化装备设计组装技术、液态填料制备技术等粉体加工技术，从产品设计、工艺优化、质量控制系统优化以及高效的流程，积极提升信息化管理水平，持续推动管理效能和盈利能力提升，持续强化内控能力。</p> <p><b>问题 5: 公司近期公告的 15000 吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目现在进展情况如何？产品用在哪些行业？</b></p> <p>答：该项目目前在设计阶段。产品主要用于环氧塑封料和覆铜板行业。</p> <p><b>问题 6: 公司扩产速度很快，也在加速抢占市场份额，且毛利率稳定在一定水平，公司为什么会有这些竞争优势？</b></p> <p>答：公司拥有在功能性陶瓷粉体填料（如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料，硅铝复合基氧化物等）领域独立自主的系统化知识产权，有近 40 年的研发经验和技术积累，在该领域具有行业领先的技术水平。我们持续建立适应市场发展的研发体系并不断储备稳定的技术团队。</p> <p>目前在环氧塑封料行业，产品应用范围广泛，从 SIP/DIP/DIS/TO/DO 、 SOP/SOT 、 到 QFN/QFP 、 BGA 、 MUF/WLP/CSP/MODULE 等封装材料基本全覆盖；在高频覆铜板应用从 NormalFR-4、Low Grade、Middle Grade 到 High Grade、PTFE Grade 基本全覆盖；在高速覆铜板应用从 Standard loss、Mid loss、low loss 到 Very low loss、Ultra low loss 基本全覆盖；在超薄板领域特别是 10ppm 以下和 anylayer HDI 应用也有很好的作为；球形氧化铝在导热界面材料领域销售持续增加，获得客户信赖。</p> <p>公司角形硅微粉具有规格全面、品质一流、供应精准，始</p>
---------------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>终坚持根据不同行业客户需求进行复配、采用多种工艺和改性剂对产品进行表面处理，深受客户信赖。</p> <p>从公司战略上来看，公司产品面向多行业、面向全球销售。</p> <p>此外，公司不断加强流程效率提升，持续提升信息化管理水平，持续提升质量管理能力，在产品质量稳定性、订单响应速度、售后服务跟踪效率、内部管理效能方面受到下游客户广泛好评和信赖。</p> <p><b>问题 7：球形氧化铝的发展节奏怎样？</b></p> <p>答：球形氧化铝目前已经拥有 3 个系列，即常规系列球形氧化铝、低钠系列球形氧化铝和高导热系列球形氧化铝；用途方面已经分为导热垫片、导热硅脂和导热凝胶、高导热塑封料、铝基板等方面；产品按粒径从 2 微米到 120 微米多种规格的单粉和 all in one 复配粉；按照不同的体系提供定制化的改性；公司产品除了在中国大陆销售，还在日本、韩国、美国、东南亚、台湾等国家和地区实现销售，公司和诸多国内外知名客户建立了紧密的合作关系，今年前三季度来自相关行业球形氧化铝粉的订单呈持续增长趋势。</p> <p><b>问题 8：公司未来有什么样的资本运作规划？</b></p> <p>答：公司的资本运作紧密围绕公司主营业务发展需要进行。如有该方面计划，公司将及时通过上海证券交易所指定信息披露网站进行披露。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求调研机构签署承诺书。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>详见附件</p>

附件

### 参会机构及人员名单

序号	参会人员	单位名称
1	薛莉丽	淳厚基金
2	吴若宗	淳厚基金
3	陈文	淳厚基金
4	张翠翠	海通证券
5	李梦媛	建信基金
6	葛新宇	国君资管
7	刘少军	泰康资产
8	赵晨曦	招商证券
9	张瑞	华安基金
10	段一帆	摩根士丹利华鑫基金
11	傅锴铭	中金公司
12	许维伦	申万证券
13	陈煜	平安资管
14	马睿	长江养老
15	胡双	申银万国
16	张勋	兴业证券
17	张俊	长江证券
18	韩翀宇	安信证券
19	赵小燕	国海证券
20	陈筛林	遵道投资
21	温浩	东方马拉松投资

序号	参会人员	单位名称
22	吴金勇	泽源资管
23	踪敬珍	海富通基金
24	高高	平安养老
25	周南	聚鸣投资
26	何增华	长信基金
27	邓小路	国金证券
28	柴沁虎	东吴石化化工
29	赵强	德邻众福投资
30	张鑫辉	德邻众福投资
31	潘建平	海之帆投资
32	李旋坤	东北证券
33	付晓军	东证宏德投资
34	王昶	东证宏德投资
35	赵文彬	璟岑投资
36	杨炜华	东莞证券
37	刘君	锦臻资产
38	张晓敏	玖歌投资
39	杨亚静	聚界联盟